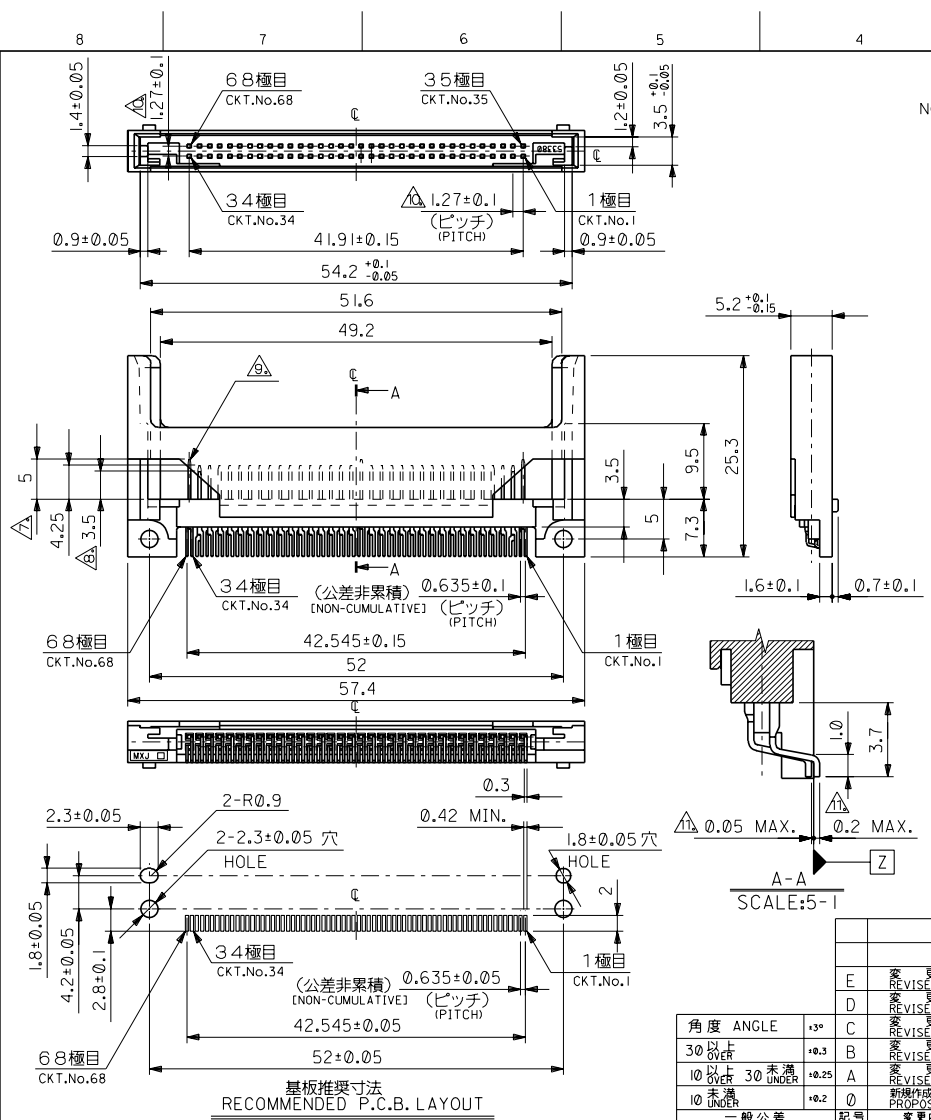


DWG. NO. SD-53380-6810

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注) NOTES 1. 材質 MATERIAL

ハウジング: ガラス入りLCP UL94V-0
 HOUSING: LCP G.F. UL94V-0
 ピン: リン青銅
 PIN: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様 PLATING

接点部: パラジウムニッケル下地、金メッキ
 CONTACT AREA: Au OVER Pd-Ni
 半田付け部: 半田メッキ
 SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD
 下地メッキ: ニッケルメッキ
 UNDERPLATING: NI OVER ALL

3. 推奨基板厚 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: $+0.8$ MIN.

4. 適合カード RECOMMENDED CARD PCMCIA TYPE I 及び II

5. 適合カード厚 RECOMMENDED CARD THICKNESS

接続部: 3.3 ± 0.1
 CONNECTING AREA: 3.3 ± 0.1
 基板部: 5 MAX.
 PCB/SUBSTRATUM AREA: 5 MAX.
 適合カード幅: 54 ± 0.1
 RECOMMENDED CARD WIDTH: 54.0 ± 0.1

6. ハウジング色 HOUSING COLOR: WHITE

- △ 寸法適用種: 1, 17, 34, 35, 51, 68
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1, 17, 34, 35, 51 AND 68.
- △ 寸法適用種: 36, 67
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 36 AND 67.
- △ ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ 0.1 MAX. とする。
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.
- △ ピン根元に適用する。
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.
- △ ソルダータールは、Z面を基準とし上へ 0.05 下へ 0.2 の範囲にあり、目づルダータールの平坦度は、 0.15 MAX. とし、テール先端にて測定する。
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.15 . MEASUREMENT POINT IS SOLDER TAILS TIP.

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$	材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
30以上 OVER	± 0.3	仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
10以上 OVER 30 UNDER	± 0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE	
10 UNDER	± 0.2	被覆外径 INS. RANGE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		DRAWN BY 92/6/1 Y. Watanabe	CHK'D BY 92/6/7
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	尺度 SCALE 2-1	DWG. NO. SD-53380-6810
	DR. DATE		REV E

molex MOLEX-JAPAN CO., LTD.
 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
 MEMORY CARD CONN.
 DUAL ROW HEADER ASS'Y
 (JEIDA Ver.4)

DWG. NO. SD-53380-6810

REV E

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32